



# iPhone 6 분해도

2014년 9월 18일의 iPhone 6 분해도.

작성자: Miroslav Djuric



## 소개

두 배의 iPhone, 두 배의 분해! **iPhone 6 Plus**는 검사하기 위해 배치하고, 우리는 더 작은 iPhone 6로 관심을 돌립니다—비록 4.7"이지만 여전히 iPhone들 사이에서는 거인입니다. 어떤 큰 부품이 이 익숙한 Apple 폼 팩터에 들어가지 못했을까요? 탈탈 털어 분해 작업대에 올려놓고 알아보시다!

올해 iPhone 6 분해도는 영어, 불어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 러시아어 및 중국어로 번역되어 있습니다. 언어를 바꾸려면 깃발 아이콘을 클릭하세요.

더 많은 분해도가 준비되어 있습니다! 자사의 [Facebook](#), [Instagram](#), 또는 [Twitter](#)를 팔로우하여 모든 최신 분해 정보를 알아보세요.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=bGIWuf92LLI>]

### 도구:

- [iSlack](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

## 단계 1 — iPhone 6 분해도



- iPhone 6 시간입니다! 몇몇 기술 사양을 확인합니다:
  - 64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
  - M8 2-세대 모션 코프로세서
  - 16, 64 또는 128GB 온보드 저장 용량
  - 4.7인치 1334x750 픽셀 (326ppi) Retina HD 디스플레이
  - 8MP iSight 카메라 (1.5 $\mu$  픽셀 및 위상 검파 자동 초점) 및 1.2MP FaceTime 카메라
  - Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
  - 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE

## 단계 2



- 우리는 새로운 등근 iPhone 6를 손에 넣기 위해 꽤 긴 줄에 서서 기다렸고 탐구할 생각에 더할 나위 없이 흥분했습니다!
- 멜버른 사무실을 분해 작업을 위해 제공한 [MacFixit Australia](#)의 좋은 친구들에게 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 재고 및 iFixit 톨킷도 판매하고 있습니다. 호주 MacFixit 고마워요!

## 단계 3



- Apple은 모델 A1586를 iPhone 6에 찍기로 결정했습니다.
- 카메라 범프는, 널리 알려진 바와 같이, iPhone 6 상단을 따라 위치한 것이 보입니다. Apple은 개선된 광학으로 휴대폰보다 약간 두꺼운 렌즈 어셈블리를 사용했습니다.
- ⓘ 이 범프가 얼마나 큰지 물으시나요? 캘리퍼스는 약 0.6mm라고 합니다.
  - 광학, 이번에는 그대가 이겼소.

## 단계 4



- iPhone 6의 둥근 모서리 디자인은 [1세대 iPhone](#)을 연상시킵니다, Lightning 커넥터와 Pentalobe/펠타로브/별나사는 제외.
- 64 비트 드라이버 키트를 사용하여 iPhone 6 Pentalobe/펠타로브/별나사를 분리합니다.
  - ⓘ 우리가 특허 나사를 싫어하는 것은 모두가 아는 사실이지만 이 iPhone은 가열 처리가 필요없는 것을 기쁘게 생각합니다.

## 단계 5



- [iSclack](#) 만세. 이 방식으로 기기를 여는 것은 매우 만족스럽습니다!

⚠ 우리는 반짝이는 이 새로운 iPhone을 공중에서 흔들만큼 iSclack을 신뢰하지만, 집에서 사용할 때 안전을 위해 두 손을 사용하세요.

- 전면 패널 어셈블리를 열고 우리는 iPhone 6 내부를 들여다 봅니다.

## 단계 6



⚠ 이 단계는 전문가 또는 전문가의 감독하에 부메랑의 부적절한 사용을 보여줍니다. 따라서, iFixit은 이 부메랑 관련 부분을 재생 또는 재연하지 말라고 부탁드립니다.

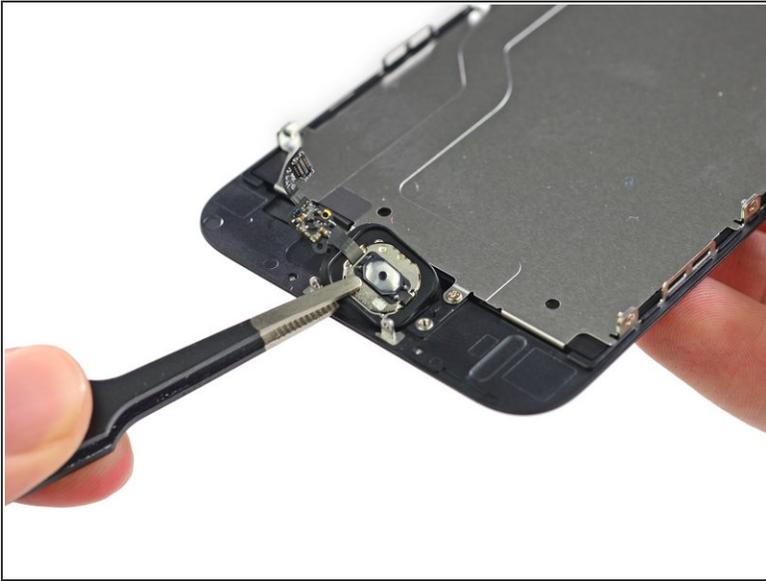
- 이것이 부메랑 사용법 맞나요? 우리는 여러 호주인들에게 물었고 모두 같은 결론을 내렸습니다. [부메랑](#)은 이렇게 사용합니다.

## 단계 7



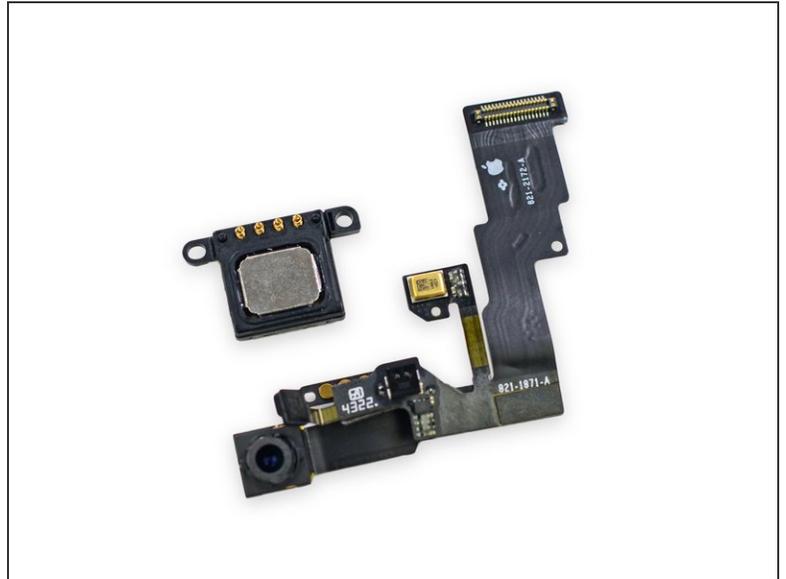
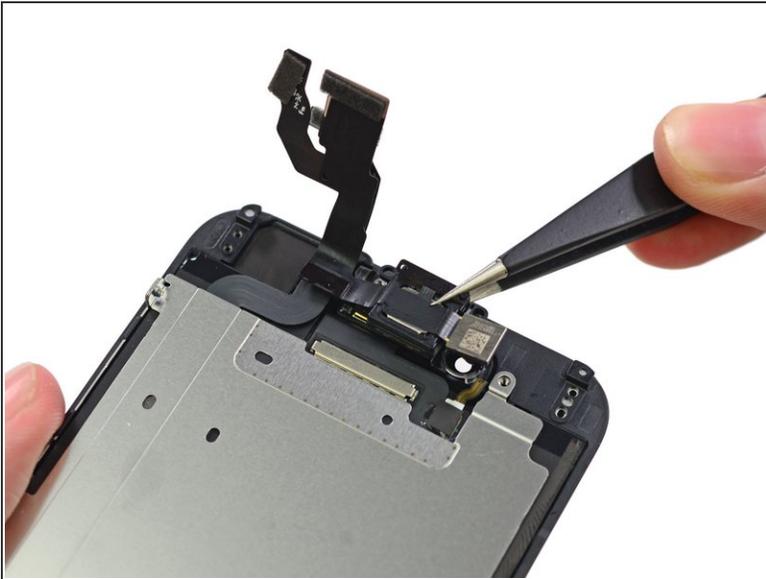
- 이 휴대폰의 외부에는 필립스 나사를 사용하지 않았지만 내부에는 존재합니다. 다행스럽게도 자사의 Pro Tech Screwdriver 세트는 이 휴대폰에 있는 모든 종류의 나사를 처리할 수 있습니다.
- 스크루 드라이버를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 제자리에 고정하는 금속 브래킷 나사와 씨름합니다.

## 단계 8



- 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼은 쉽게 떼낼 수 있습니다—하지만, 여전히, 첨단 외과 의사의 노련한 손 없이는 주변 고무 개스킷이 쉽게 찢어집니다.

## 단계 9



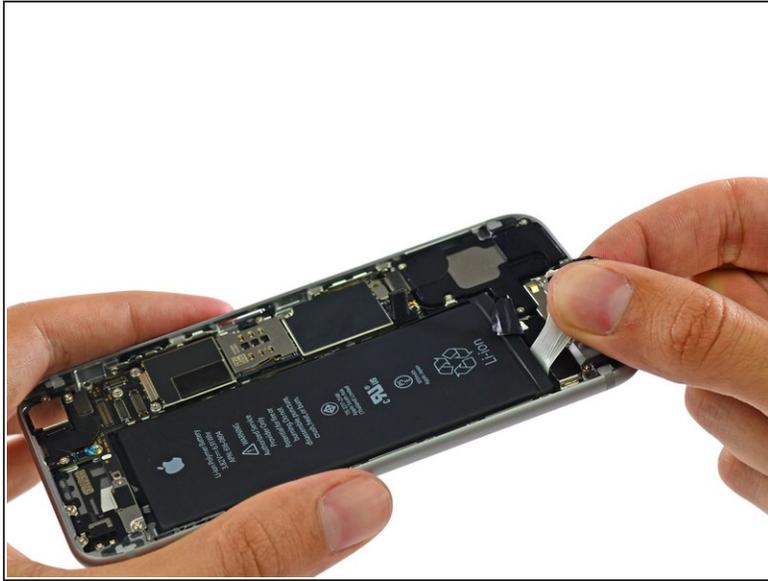
- iPhone 6 Plus와 마찬가지로 전면 카메라 및 이어피스 스피커는 전면 패널 어셈블리에 있습니다.
- 우리는 그 부품들을 분리하여 검사를 위해 정렬합니다.

## 단계 10



- 현재까지, 이 "소형" iPhone 6의 전체 구조는 대형 6 Plus의 판박이입니다.
- 이 금속판과 전면 패널 어셈블리가 완벽한 예입니다. 이 경우는 확실히 개선한, [iPhone 6 Plus의 디자인을 반영합니다.](#)

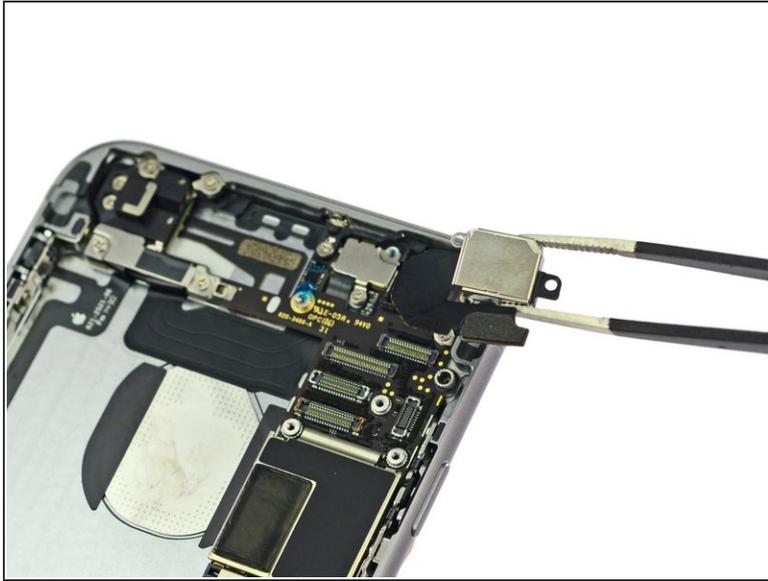
## 단계 11



- 우리는 이런 배터리 당김 탭을 좋아합니다. 제대로 잡아 당기면 비집는 도구를 사용하여 배터리를 구슬리는 번거로움 (및 잠재적 위험)을 줄일 수 있습니다.
- 이 접착제는 3M Command 접착제와 유사하며 제대로 탭을 당기면 스트립 전체가 떨어집니다.



## 단계 13



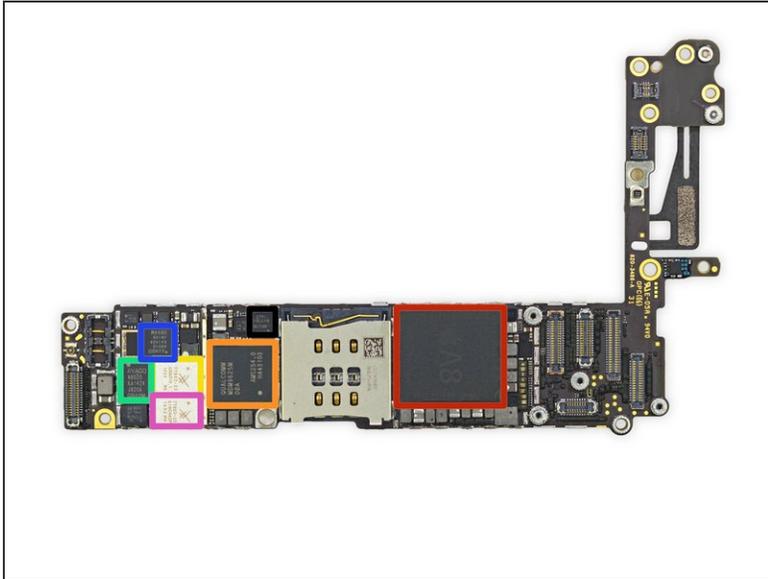
- 여러분, 좋은 소식이 있습니다! 후면 카메라는 핀셋 하나로 쉽게 분리할 수 있습니다.
- 비록 iPhone 6에는 [iPhone 6 Plus](#) 카메라의 멋진 광학 이미지 흔들림 보정 기능은 없지만 그 외 거의 모든 사양을 공유합니다: 8 메가픽셀, f/2.2 조리개, True Tone 플래시 및 위상 검파 자동 초점.
- 또한 이미지 처리 기술을 사용하여 OIS (광학 이미지 흔들림 보정)의 효과를 모방하는 전자 이미지 흔들림 보정 기능이 있습니다.

## 단계 14



- [왕왕 거리는 보드 게임](#)에서 귀찮은 부품을 제거하는 것보다 더 빠르게 안테나를 분리합니다.
- ⓘ 우리는 작업을 마스터하고 빠르게 진행합니다.
- 다음은 로직 보드입니다. EMI 실드를 우아하게 입고 있지만 베일 아래에 무엇이 있는지 확인하고 싶습니다.

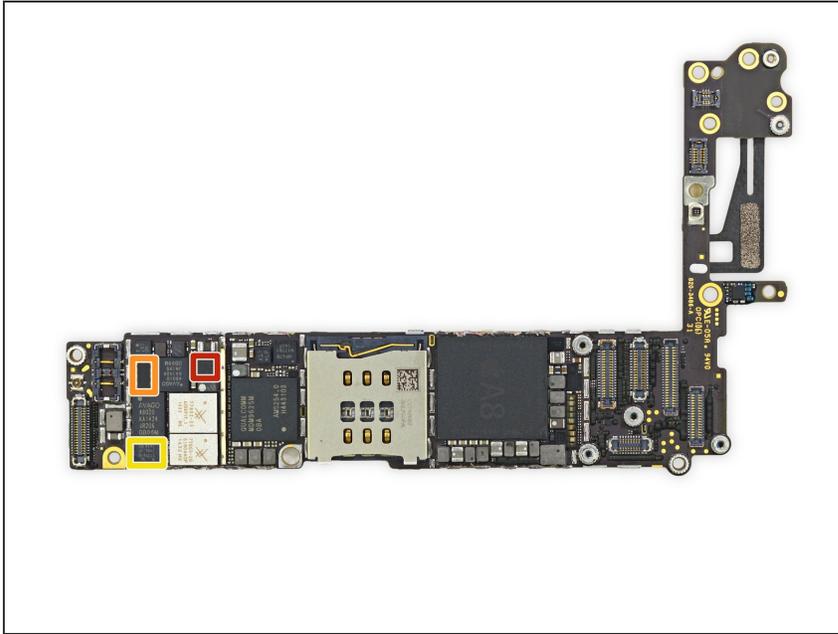
## 단계 15



- 로직 보드 전면:

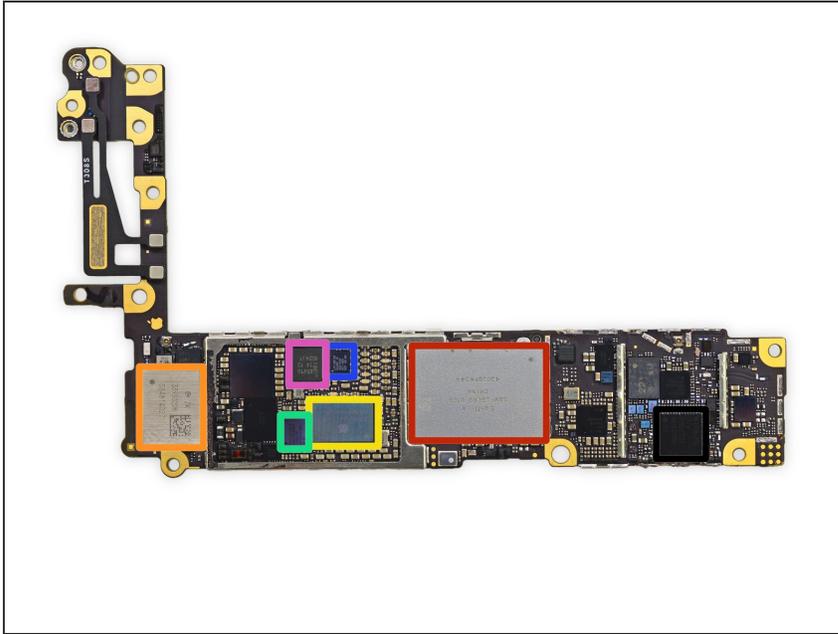
- H9CKNNN8KTMRWR-NTH 표시 Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM (iPhone 6 Plus와 동일한 1GB LPDDR3 RAM으로 가정)
- Qualcomm [MDM9625M](#) LTE 모뎀
- Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
- Avago A8020 High Band PAD
- Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
- Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD
- InvenSense MP67B 6-축 자이로스코프와 가속도계 콤보

## 단계 16



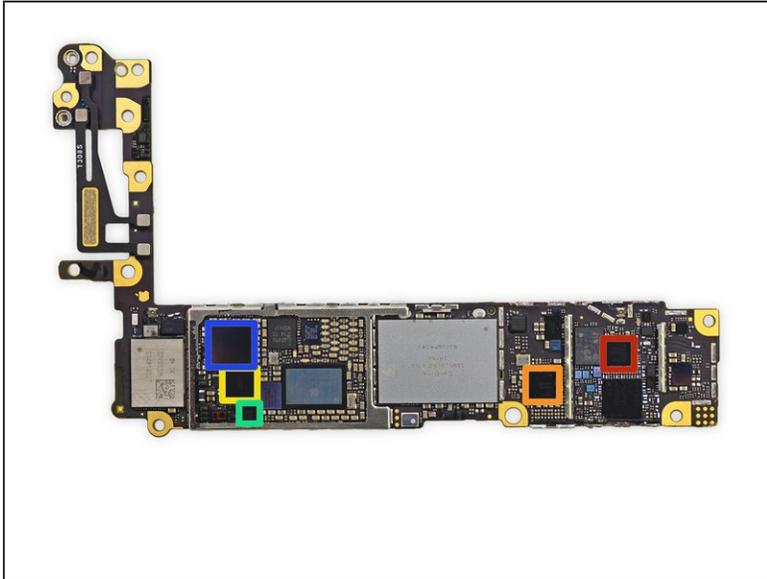
- 로직 보드 전면의 더 많은 IC:
  - Qualcomm [QFE1100](#) 엔벨롭 트랙킹 IC
  - RF Micro Devices [RF5159](#) 안테나 스위치 모듈
  - Skyworks 77356-8 Mid Band PAD

## 단계 17



- 로직 보드의 후면:
  - SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND 플래시
  - Murata 339S0228 Wi-Fi 모듈
  - Apple/Dialog 338S1251-AZ 전원 관리 IC
  - Broadcom [BCM5976](#) 터치스크린 컨트롤러
  - NXP [LPC18B1UK](#) ARM Cortex-M3 Microcontroller (별칭 M8 모션 코프로세서)
  - NXP 65V10 NFC 모듈 + Secure Element (아마도 NXP [PN544](#) NFC 컨트롤러 내장)
- Qualcomm [WTR1625L](#) RF 송수신기

## 단계 18



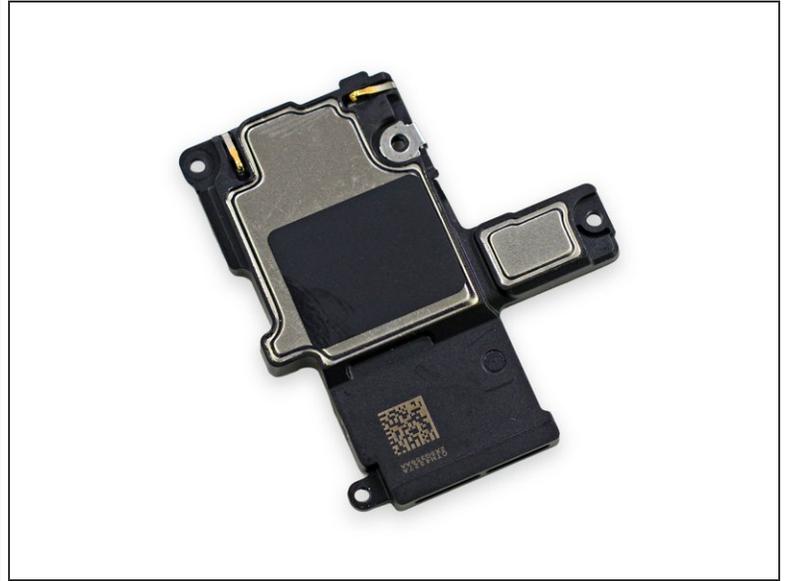
- 로직 보드 후면에 더 많은 IC가 기다리고 있습니다:
  - Qualcomm WFR1620 수신-전용 동반 칩. Qualcomm은 WFR1620는 "WTR1625L을 사용하여 캐리어 어그리게이션 이행에 필요하다"고 합니다.
  - Qualcomm PM8019 전원 관리 IC
  - Texas Instruments 343S0694 Touch 송신기
  - AMS [AS3923](#) NFC Booster IC는 "모바일과 웨어러블 처럼 까다로운 환경의 기존 NFC 컨트롤러 성능 향상" 및 "덜 제한적인 안테나 설계 요구 사항"을 제공하도록 설계하였습니다.
    - 우리는 이 칩이 '활성 피어투피어 비트 전송률 [최대] 212kb/s'를 사용하여 떠들썩한 환경에서 성능을 향상시키기 위해 준비중인 NFC라고 생각합니다.
  - Cirrus Logic [338S1201](#) 오디오 코덱
- ☞ 이 모든 기기를 식별할 수 있도록 도와준 [Chipworks](#) 친구들에게 대단히-감사한 마음을 전합니다. 그들의 도움없이는 하지 못했을 것입니다!

## 단계 19



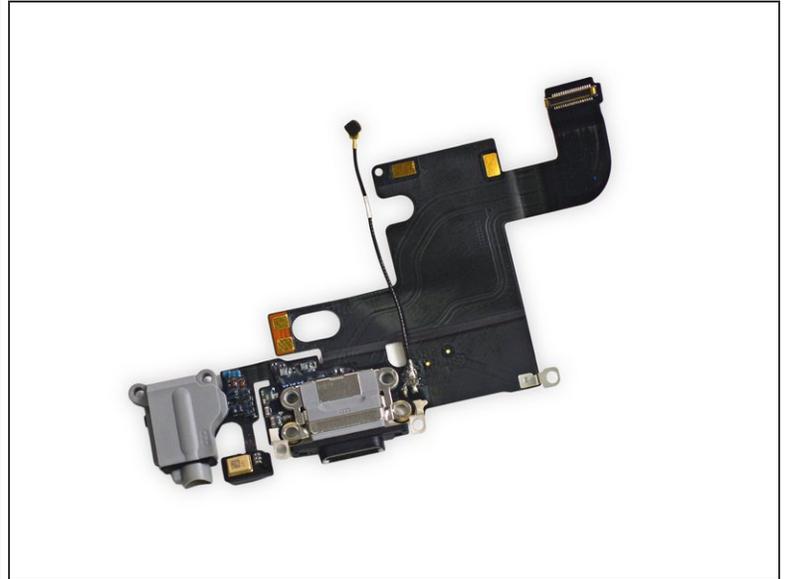
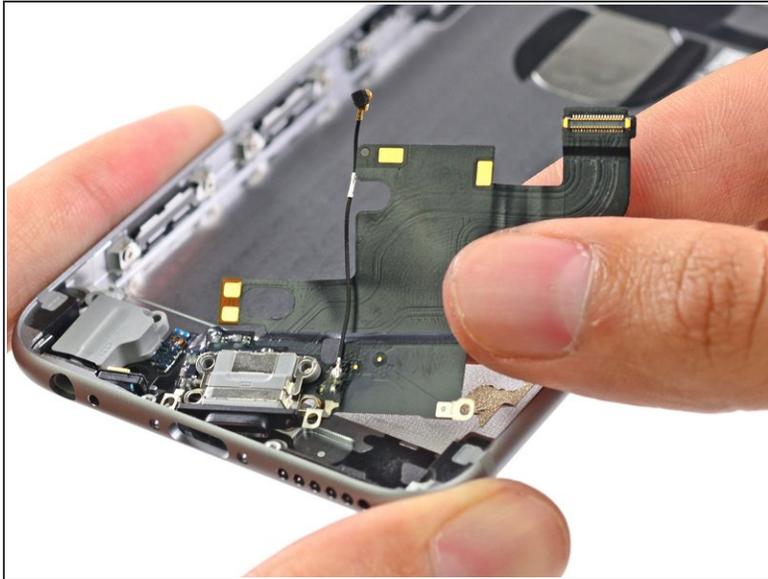
- 진동기 어셈블리 분리. 새롭고... 개선했나?
- 진동기 메커니즘은 코카콜라 또는 펩시콜라 중 하나를 선택하는 것처럼 명확한 답이 없는 것 같습니다. Apple은 이 부품 디자인을 계속 바꾸고 있습니다:
  - [iPhone 4](#)(카운터 급)
  - [iPhone 4S](#) (선형 진동)
  - [iPhone 5/5s](#) (카운터 급)
- 외형을 보면, 우리는 이 Apple iPhone 버전은 선형 진동 디자인을 사용한다고 추측합니다.

## 단계 20



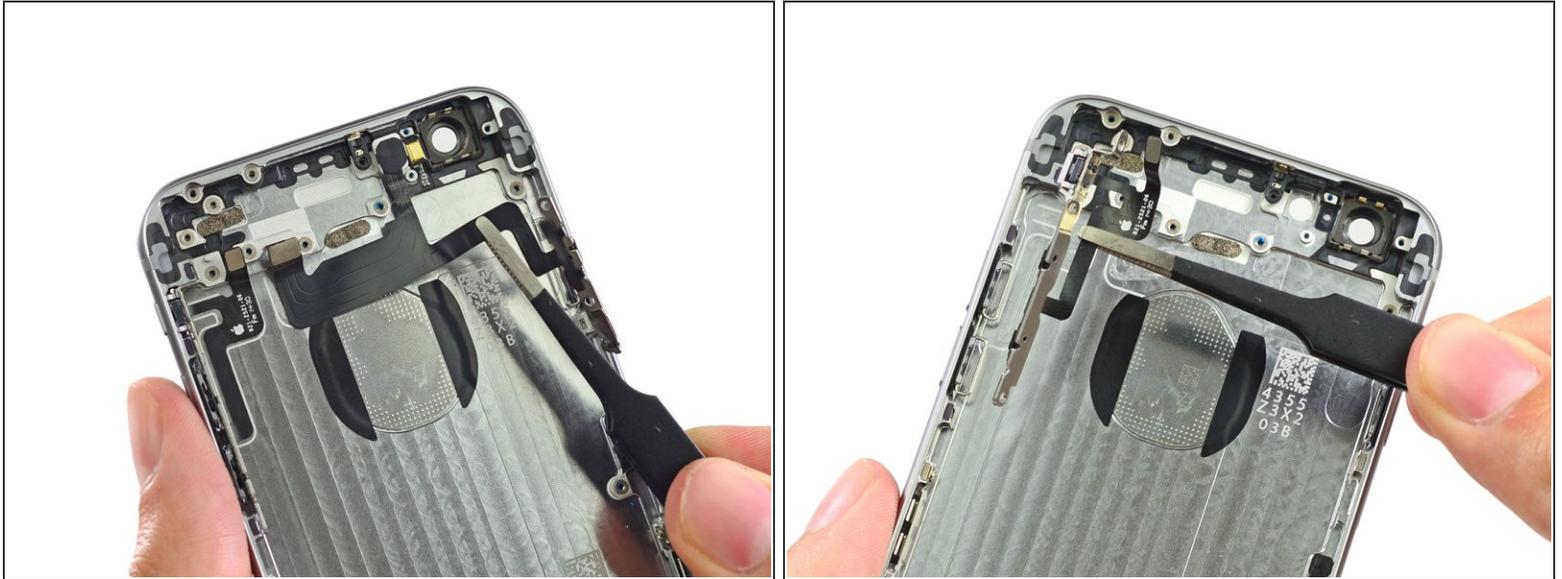
- 올해의 모델은 새로운 스피커 어셈블리 디자인을 자랑합니다.
- 표식이 거의 없는 관계로, 우리는 [iPhone 5s 스피커](#)의 작은 업데이트로 예상됩니다.

## 단계 21



- 우리는 헤드폰 잭과 Lightning 커넥터로 선언합니다. 이제 이 두 부품은 단일 케이블로 연결된 하나의 어셈블리가 되었습니다.
- 이 새로운 결합은 더 이상 부품 한 개만을 교체할 수 없다는 것을 의미합니다—만약 포트가 고장나면 골치아픈 문제입니다.

## 단계 22



- [핀셋](#)은 우리의 삶을 편리하게 합니다. 전원 버튼 및 음량 버튼과 같이 부서지기 쉬운 케이블 어셈블리를 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
  - 그렇게, 버튼 어셈블리는 iPhone 커버에서 나옵니다.
- i** 이는 [iPhone 6 Plus](#)의 어셈블리와 매우 유사합니다.

## 단계 23



- 다 끝났습니다. iPhone 6는 꽤 괜찮은 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
- iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
- 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
- 지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
- iPhone 6 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
- Apple은 iPhone 6의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.